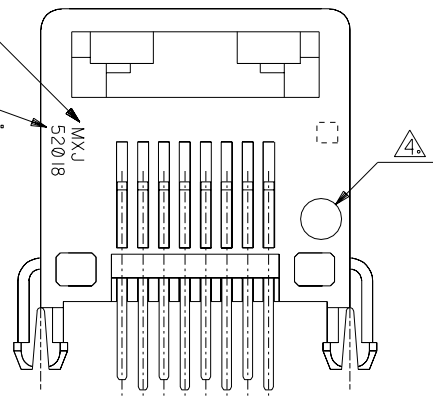
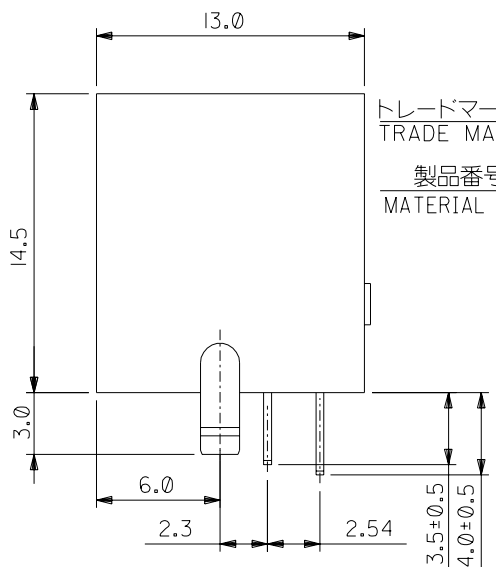
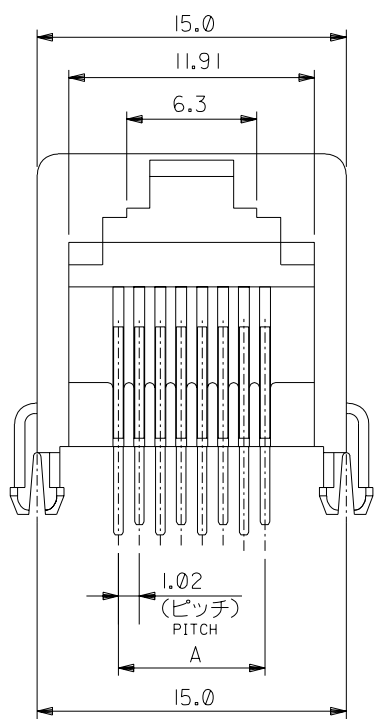


:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

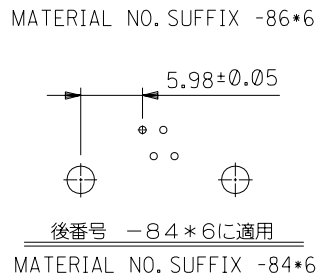
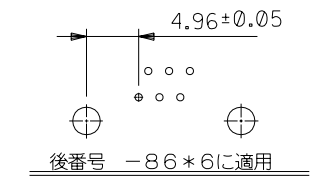
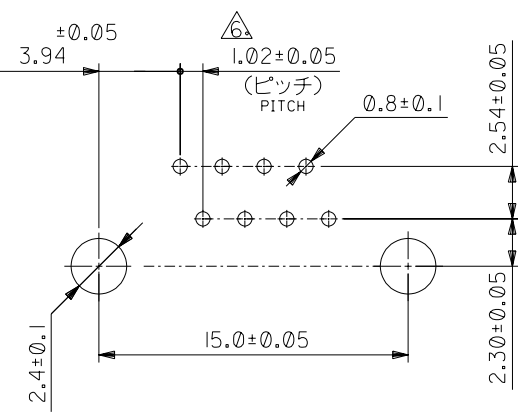
ENG. NO. SD-52018-001

EDP NO. #



注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG. : POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM. : PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING
接点部 : 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 錫メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA : TIN 1.0µmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE : NICKEL 1.0µmMIN.
- 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN. 緑色: 0.38µmMIN.
YELLOW : 0.1µmMIN. GREEN : 0.38µmMIN.
オレンジ色: 0.76µmMIN. 無色: 1.27µmMIN.
ORANGE : 0.76µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.
- ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
- 公差非累積。
NON-ACCUMULATIVE
- 本製品は 52018-8**5 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-8**5.



後番号 -88*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -88*6

後番号 -86*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -86*6

後番号 -82*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -82*6

基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
MATERIAL NO. SUFFIX -84*6

8	8	7.11	1.27	52018-8846
			0.76	-8836
			0.38	-8826
			0.1	-8816
				-8816
	6	5.08	1.27	-8646
	4	3.05	1.27	-8446
	2	1.02	1.27	52018-8246

52018-8**6	ポジション	極数	(A)	金メッキ厚(µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.)	製品番号 MATERIAL No.
MODEL NO.	POSITION	CIRCUITS			
				注参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
				仕上げ 注及び表参照 FINISH SEE NOTES AND CHART	EDP. NO. #
				適用電線範囲 WIRE RANGE	ENG. NO. SD-52018-001
				被覆外径 INS. RANGE	REV 0
				DRAWN BY: 04/04/28 M.NABEI CHK'D BY: 04/04/28 K.TOJO	TITLE 名称 MODULAR JACK HOUSING ASS'Y -LEAD FREE-
				APP'D BY: 04/04/28 M.SASAO SCALE 4 - 1	

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	+0.3
10以上 OVER 30未満 UNDER	+0.25
10未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

新規作成 (2004-4035) 04/04/28
REVISION RECORD DR. DATE
M.NABEI
M.SASAO